



RE899

- Multiadaptador para SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8
- Pitch 1,27 mm
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura Ø 2,20 mm, Pin 1 cuadrados
- Se ajusta a zócalos con una distancia de 7,62 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 16,51 x 21,59 mm